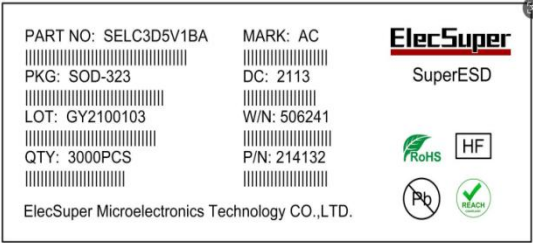





产品包装变更通知函

一、目的

提升产品质量，规范产品包装。

二、变更项目

项目 1：标签	
变更内容： 1、公司名称、LOGO 变更； 2、增加产品 MSL 等级； 3、颜色变更。	
变更前	变更后
 <p>The previous label design for ElecSuper Microelectronics Technology CO.,LTD. It includes part number SELC3D5V1BA, package SOD-323, lot GY2100103, and quantity 3000PCS. It features the ElecSuper logo and various compliance marks like RoHS, HF, and REACH.</p>	 <p>The new label design for ElecSuper Semiconductor Technology CO.,LTD. It includes the same part number and quantity, but adds the MSL Level 3 marking and updates the company name and logo to ElecSuper SEMI.</p>
项目 2：包装材料	
变更内容：所有卷盘出货产品增加铝箔袋、干燥剂、抽真空。	
变更前	变更后
 <p>The previous packaging shows a roll of material wrapped in clear plastic, without the new aluminum foil bag, desiccant, or vacuum seal.</p>	 <p>The new packaging shows the roll of material now wrapped in a silver aluminum foil bag, which includes a desiccant packet and is sealed under vacuum.</p>

项目 3：包装数量	
<p>变更内容：</p> <p>15 盘/内盒，变更为 10 盘/内盒。</p> <p>涉及封装如下：</p> <p>SOT-143/SOT-23/SOT23-3L/SOT23-5L/SOT23-6L/SOT-323/SOT-353/SOT-363/ SOT-523/SOT-553/SOT-563/SOT-723/SOD323/SOD523/SOD923。</p>	
项目 4：内盒、外箱	
<p>变更内容：</p> <p>1、去掉静芯微品牌 LOGO；</p> <p>2、外箱贴静芯半导体 LOGO 标签。</p> <p>注：变更后内盒、外箱具体规格以封装厂实际提供为准。</p>	
变更前	变更后
	
	



三、变更时间

库存出货按原包装规范执行，新产出回货按新包装规范执行。2025-3-15 开始陆续执行，预计 2026-Q1 全部变更完成。

湖南静芯微电子技术有限公司 品质部

湖南静芯半导体科技有限公司 品质部

品质专用章

2025.3.3